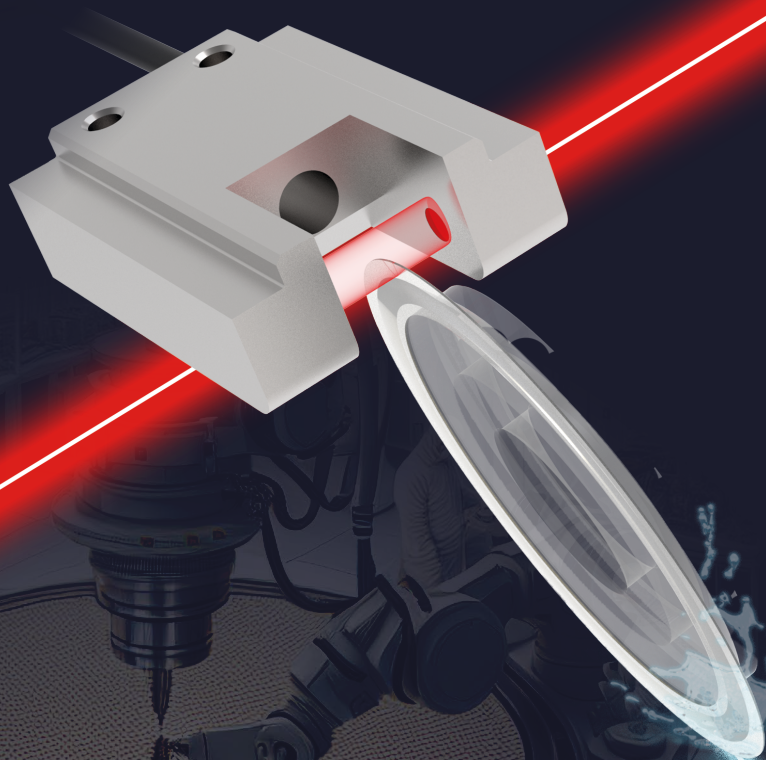


VBI

破刀侦测



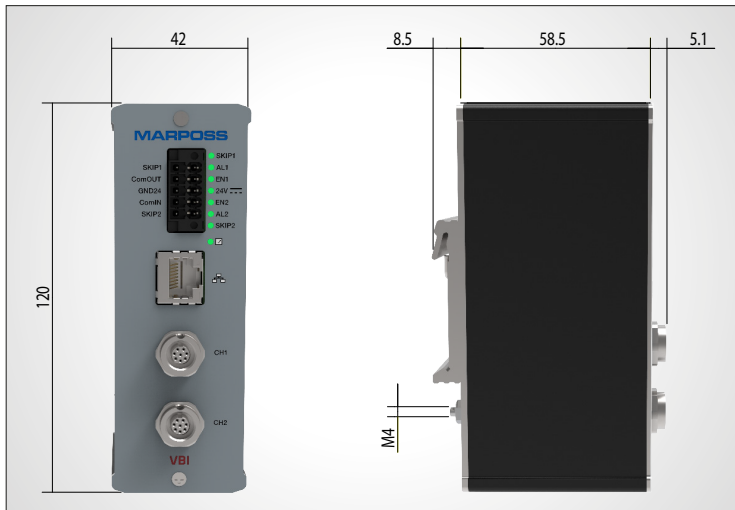
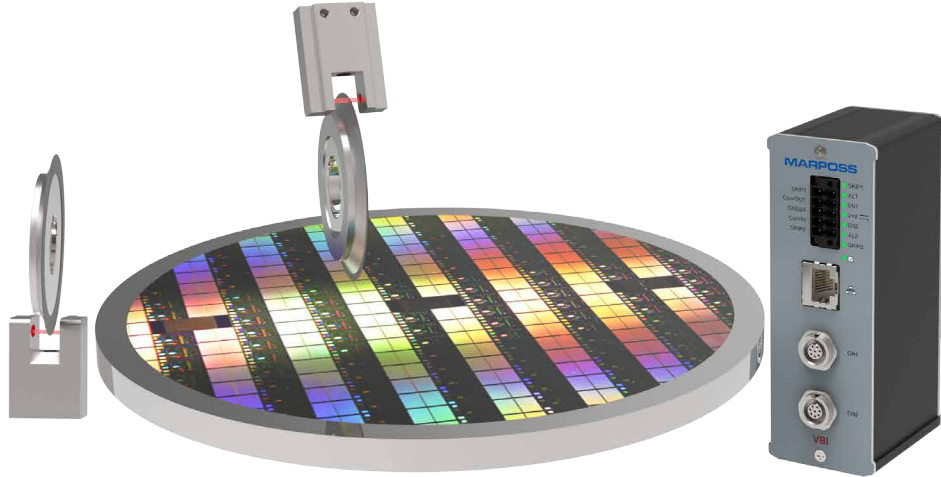
刀刀精准



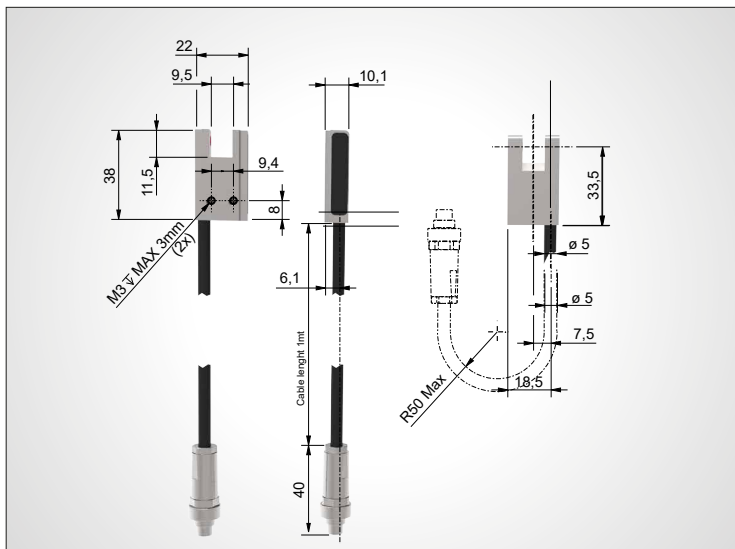
MARPOSS

破刀侦测

在半导体生产中，精准首当其冲。在芯片生产的全过程中，划片工序是其中极其精细的工序之一。马波斯破刀侦测方案可在晶圆切割中监控切割刀，确保晶圆切割结果的高质量和高可靠性，有效减少废品。马波斯VBI破刀侦测方案极致提升生产效率和质量，同时显著缩短划片时间。




指示灯	电源和I/O状态，工作状态和连接状态
接口	以太网接口 x 1（与外部通信用）
最大测头数	2
最高图像采样率	125 KHz
可编程循环	NCS（非接触式测高） BBD（切割刀破损检测）
I/O	隔离式 Sink/Source式连接（参见如下示例） 输入电路类型1 - 24 Vdc 输出电路24 Vdc / 最大100 mA
电源单元 / 功耗	24V直流 SELV - PELV型。
防护等级 <i>IEC 60529标准</i>	IP30



测头	
发光方式	LED
接收方式	线阵图像传感器
防护等级	传感器IP68 接头IP50
最大线缆长度	1 m

10/2024版 - 技术规格如有变更，恕不另行通知。© 2024年版权所有，马波斯 (MARPOSS S.p.A.) (意大利) - 保留全部权利。

未经事先书面同意，不得将本文档及其内容的全部或部分用于未明确允许的目的。
MARPOSS、 和这里所示的马波斯集团的其它名称及标志是马波斯 (Marposs S.p.A.) 或马波斯集团在美国和其他国家的商标或注册商标。
如果将产品出口到欧盟以外的国家，产品线中的部分产品或其零件可能涉及出口限制或相应国家、超国家或国际机构可能采取限制性措施。